

CLIPPEDIMAGE= JP02000275191A
PAT-NO: JP02000275191A
DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2000275191 A
TITLE: X-RAY INSPECTING METHOD AND APPARATUS

PUBN-DATE: October 6, 2000

INVENTOR-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
TERAOKA, AKIRA	N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
TECHNO ENAMI:KK	N/A

APPL-NO: JP11082501
APPL-DATE: March 25, 1999

INT-CL_(IPC): G01N023/04; H05K003/34

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an X-ray inspecting apparatus capable of clearly judging the mounting state of a small-sized and highly densified electronic parts such as BGA or CSP to a substrate, particularly the lifting inferiority of a solder ball.

SOLUTION: In the X-ray inspecting apparatus constituted so that an X-ray source 11 emitting X-rays and an X-ray detecting part 12 detecting X-rays are arranged in opposed relationship with a sample 13 inbetween and X-rays emitted from the X-ray source 11 to be transmitted through a sample are detected by the X-ray detecting part 12, the X-ray detecting part 12 is arranged so that the X-ray incident surface 12a thereof becomes parallel to an axis S and an oscillation means 16 oscillating the X-ray detecting means 12 centering around the axis S while always turning the X-ray incident surface 12a thereof in the same direction and a rotary means 15 rotating the X-ray source 11 around the axis S in synchronous relation to the X-ray detecting part 12.

COPYRIGHT: (C) 2000, JPO

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-275191

(P2000-275191A)

(43)公開日 平成12年10月6日(2000.10.6)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード*(参考)
G 0 1 N 23/04		G 0 1 N 23/04	2 G 0 0 1
H 0 5 K 3/34	5 1 2	H 0 5 K 3/34	5 1 2 B 5 E 3 1 9

審査請求 未請求 請求項の数11 O L (全 11 頁)

(21)出願番号 特願平11-82501

(22)出願日 平成11年3月25日(1999.3.25)

(71)出願人 597028542

株式会社テクノエナミ

大阪府堺市八田北町三五三

(72)発明者 寺岡 璋

大阪府泉南郡熊取町希望が丘四丁目13番25号

(74)代理人 100096080

弁理士 井内 龍二

Fターム(参考) 2G001 AA01 BA11 CA01 DA01 DA02

FA06 GA06 GA13 HA13 HA14

JA01 JA02 JA06 JA11 JA13

KA03 LA11 MA05 SA02

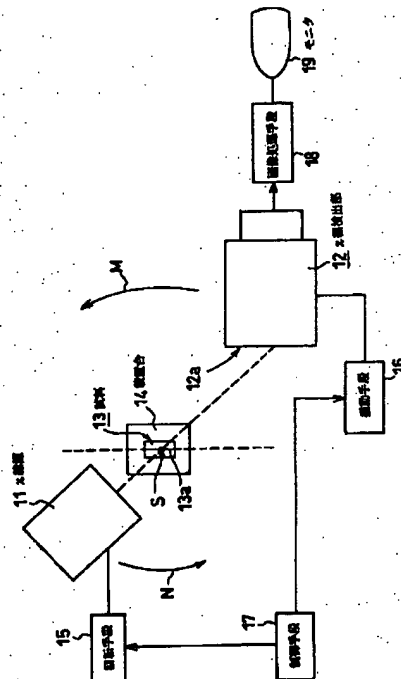
5E319 AC01 CD52

(54)【発明の名称】 X線検査方法及びその装置

(57)【要約】

【課題】 小型・高密度化するBGAやCSP等の電子部品の基板への実装状態、特に半田ボールの浮き上がり不良等を明確に判断することのできるX線検査装置を提供すること。

【解決手段】 試料13を挟んで、X線を照射するX線源11とX線を検出するX線検出部12とが対向して配置され、X線源11から照射され、試料13を透過したX線がX線検出部12にて検出されるように構成されたX線検査装置において、X線検出部12のX線入射面12aが軸Sに対し平行となるように配置されると共に、X線入射面12aを常に同方向に向かせたまま、X線検出部12を、軸Sを中心軸として、揺動させる揺動手段16と、X線源11を、軸Sを回転軸として、X線検出部12に同期させて回転させる回転手段15とを装備する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 X線を用いて試料の断面を撮影して検査するX線検査方法において、

前記試料を挟んで、X線を照射するX線源とX線を検出するX線検出部とを対向させて配置し、

前記X線検出部のX線入射面と前記断面とを平行にして、

前記X線入射面と前記断面との平行関係を維持させたまま、

前記X線検出部を、前記断面と同一面上にある直線を中心軸として、揺動させる一方、前記X線源を、前記断面と同一面上にある前記直線を回転軸として、前記X線検出部に同期させて回転させながら、

前記X線源からX線を前記試料に照射し、前記試料を透過したX線を前記X線検出部にて検出することを特徴とするX線検査方法。

【請求項2】 被検対象となる断面を、前記試料を載置する載置台に対して垂直方向に関する断面とすることを特徴とする請求項1記載のX線検査方法。

【請求項3】 被検対象となる断面を、前記試料を載置する載置台に対して垂直方向以外に関する断面とすることを特徴とする請求項1記載のX線検査方法。

【請求項4】 前記中心軸及び前記回転軸となる前記直線を、前記試料を載置する載置台に対して垂直に設定することを特徴とする請求項1又は請求項2記載のX線検査方法。

【請求項5】 試料を挟んで、X線を照射するX線源とX線を検出するX線検出部とが対向して配置され、

前記X線源から照射され、前記試料を透過したX線が前記X線検出部にて検出されるように構成されたX線検査装置において、

前記X線検出部のX線入射面が所定の直線に対し平行となるように配置されると共に、

前記X線入射面を常に同方向に向かせたまま、前記X線検出部を、前記直線を中心軸として、揺動させる揺動手段と、

前記X線源を、前記直線を回転軸として、前記X線検出部に同期させて回転させる第1の回転手段とを備えていることを特徴とするX線検査装置。

【請求項6】 前記直線を含み、かつ前記X線入射面と平行関係にある面と同一面上にある前記試料の断面を被検対象とし、

前記断面が、前記試料を載置する載置台に対して垂直方向にあることを特徴とする請求項5記載のX線検査装置。

【請求項7】 前記直線を含み、かつ前記X線入射面と平行関係にある面と同一面上にある前記試料の断面を被検対象とし、

前記断面が、前記試料を載置する載置台に対して垂直方向以外にあることを特徴とする請求項5記載のX線検査

装置。

【請求項8】 前記中心軸及び前記回転軸となる前記直線が、前記試料を載置する載置台に対して垂直に設定されていることを特徴とする請求項5又は請求項6記載のX線検査装置。

【請求項9】 前記X線検出部を、前記X線入射面に対して垂直方向にスライドさせるスライド機構を備えていることを特徴とする請求項5～8のいずれかの項に記載のX線検査装置。

10 【請求項10】 前記試料を載置する載置台を2次元的に移動させるための載置台移動手段を備えていることを特徴とする請求項5～9のいずれかの項に記載のX線検査装置。

【請求項11】 X線を照射するX線源とX線を検出するX線検出部とが配置され、

前記X線源から照射され、試料を透過したX線が前記X線検出部にて検出されるように構成されたX線検査装置において、

前記X線源を、所定の直線を回転軸として、回転させる第2の回転手段を備えると共に、

前記X線検出部が複数配置され、

20 これらX線検出部のX線入射面が、前記直線を含む所定の面を基準とし、回転する前記X線源と一定の幾何学的関係を成立させ得る位置にそれぞれ配設されていることを特徴とするX線検査装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明はX線検査方法及びその装置に関し、より詳細には、小型・高密度化するBGA (Ball Grid Array) やCSP (Chip Scale Package) 等の電子部品の基板への実装状態 (接合状態) 等をX線を用いて検査するためのX線検査方法及びその装置に関する。

【0002】

【従来の技術】近年、携帯電話、パーソナルコンピュータ、映像・音声機器等における、その高性能化には目覚ましいものがある。それを可能にしているのは、その核となるIC実装技術であり、ICチップを搭載するためのパッケージの高密度化・信号処理の高速化が進んでいる。特に、昨今、革新的な手法として登場した、多端子化に有効なBGAやCSP等のアレイパッケージが注目を集めている。

【0003】しかしながら、BGA等のアレイパッケージは多端子化には優れているが、その構造上、プリント基板に実装した場合に、パッケージ本体によりパッケージとプリント基板との接合部が隠れてしまうので、光学式/レーザ式等の外観検査ではプリント基板との接合状態の良否を判断することが難しいといった問題がある。

また、ファインピッチ化されたパッケージにおいては、電気検査によっても、不良箇所の部位を特定することは

困難である。

【0004】図11はBGA1の一例を模式的に示した斜視図であり、図12は図11に示したBGA1が実装された状態のプリント基板2を模式的に示した斜視図である。図12より明らかなように、最外周以外の部分に配設されている半田ボール1aとプリント基板2との接合状態の良否を、外観から判断することは難しい。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】現在、BGA等のレイパッケージとプリント基板との接合状態を検査する技術としては、接合箇所に対して、所定方向からの2次元、3次元の多様で明確な透視画像を得る方式(X線透過方式)や、前記接合箇所に対して、プリント基板の主面に対して平行な面でスライスしたような断層画像(いわゆる、横断層画像)を得る方式(X線断層撮影方式)がある。X線透過方式を採用した装置として、X線3次元検査装置がある。図13は透過式X線3次元検査装置を用いて前記接合箇所を撮影したX線写真である。

【0006】図13から明らかなように、X線3次元検査装置を利用することで、外側からでは観察することのできない内部形状を透視画像として観察することができるので、内部形状が複雑であったとしても、かなり明確に内部状態の良否を判断することができるようになる。

【0007】しかしながら、昨今の高密度実装の中核をなしている、BGAやCSP等のレイパッケージの実装に対しては、使用者が最も検査したい端子部(半田ボール)の浮き上がり(オープン)不良を明確に検出することは難しいといった問題がある。図14に半田ボールの浮き上がり不良の状態を模式的に示す。

【0008】また、X線断層撮影方式を用いることによって、前記接合箇所の2つ以上の高さで横断層(水平スライス)画像を取得し、陰影の度合いを測定することで、内部の形状をある程度は検査することができる。

【0009】しかしながら、横断層画像におけるスライス状の断層画像から、BGAやCSP等のレイパッケージの実装における、端子部(半田ボール)の浮き上がり不良を明確に検出することは、実際には非常に困難を伴う。

【0010】本発明は上記課題に鑑みなされたものであって、小型・高密度化するBGAやCSP等の電子部品の基板への実装状態、特に端子部の浮き上がり不良等、電子機器の状態を明確に判断することのできるX線検査方法及びその装置を提供することを目的としている。

【0011】

【課題を解決するための手段及びその効果】上記したように、従来、パッケージ本体により隠れてしまうBGA等のレイパッケージとプリント基板との接合部を、平面や斜め方向からの透視画像(図13参照)や、横断層画像を用いて検査していたが、端子部(半田ボール)の浮き上がり不良までは明確に検出することはできなかつ

た。

【0012】そこで、本発明者は、半田ボールの浮き上がり不良(図14参照)が、BGA1やプリント基板2の主面に対する平行方向に関して生じる問題というよりは、垂直方向に関して生じる問題であることに着目し、従来のように、プリント基板2の主面に対して平行にスライスしたような断層画像(横断層画像)ではなく、プリント基板2の主面に対して垂直方向となる断層画像(いわゆる、縦断層画像)を取得することによって、半田ボール1aの浮き上がり不良の検出がし易くなることを見出し、本発明を完成するに至った。

【0013】図1は前記接合箇所の縦断層画像を示した模式図であり、(a)は接合不良箇所がない場合を示しており、(b)は半田ボール1aの浮き上がり不良がある場合を示している。

【0014】すなわち、本発明に係るX線検査方法

(1)は、X線を用いて試料の断面を撮影して検査するX線検査方法において、前記試料を挟んで、X線を照射するX線源とX線を検出するX線検出部とを対向させて配置し、前記X線検出部のX線入射面と前記断面とを平行にして、前記X線入射面と前記断面との平行関係を維持させたまま、前記X線検出部を、前記断面と同一面上にある直線を中心軸として、揺動させる一方、前記X線源を、前記断面と同一面上にある前記直線を回転軸として、前記X線検出部に同期させて回転させながら、前記X線源からX線を前記試料に照射し、前記試料を透過したX線を前記X線検出部にて検出することを特徴としている。

【0015】上記X線検査方法(1)によれば、被検対象となる前記試料を挟んで、前記X線源と前記X線検出部とを対向させて配置し、前記X線入射面と前記断面とを平行にして、前記X線検出部と前記断面との平行関係を維持させたまま、前記X線検出部を前記断面と同一面上にある直線を中心軸として揺動させる一方、前記X線源を前記直線を回転軸として前記X線検出部に同期させて回転させながら、前記X線源からX線を前記試料に照射し、前記試料を透過したX線を前記X線検出部にて検出する。

【0016】すなわち、被検対象となる前記試料の断面を基準とし、前記X線源と前記X線検出部とを一定の幾何学的関係を維持させたまま互いに運動させると、該運動の基準部分となる前記断面部分は不動と看做し得る状態となり、それ以外の部分は前記運動の基準部分から遠くなるほど、像の変形が大きくなり、結果的には像がボケてしまって、視認の対象とならなくなる。

【0017】かかる原理を、上記X線検査方法(1)を説明するために示した図2～図4の模式図を使って説明する。図2は平面図を示し、図3は正面図を示し、図4は側面図を示している。また、図5は試料を模式的に示した斜視図である。

【0018】図中13は試料を示しており、試料13は載置台14に載置され、斜線部13aは被検対象となる試料13の断面を示している。点A、B、D、E、Fは断面13a上にあり、点B、A、Dは同一直線L₁上にあり、点E、A、Fは同一直線L₂上にあり、直線L₁と直線L₂とは直交している。また、試料13内の点Kは、断面13a上にはなく、断面13a上の点Bから距離mのところに位置している。

【0019】また、試料13を挟んで、X線源11とX線検出部12とを対向させて配置し、X線源11からX線を照射し、試料13を透過したX線をX線検出部12にて検出している。

【0020】イ) X線検出部12のX線入射面12aと試料13の断面13aとを平行にすることによって、断面13a上の点A、B、D、E、Fは、Hに位置するX線検出部12のX線入射面12aに対し、それぞれ点a、b、d、e、fに入射される。なお、ここでは点a*

幾何学的拡大率

$$=Ga/GA=Gb/GB=Gd/GD=Ge/GE=Gf/GF$$

$$=ga/gA=gb/gB=gd/gD=ge/gE=gf/gF$$

また、断面13aより距離mの位置にある点Kは、Hに位置するX線入射面12aに対し、点k_Hに入射され、hに位置するX線入射面12aに対し、点k_hに入射される。点Kの入射される位置は、(口)の運動時に距離r₅のズレが生じており、結果的には像がボケてしまい、映像が流れて固定されない。

【0025】すなわち、上記X線検査方法(1)によって、X線検出部12から取得することのできる映像は、直線L₁を含み、X線入射面12aと平行な関係にある断面13aの形状となる。換言すれば、X線源11の回転軸であり、X線検出部12の中心軸である直線L₁を含み、X線入射面12aと平行な関係にある断面13aの断層画像を取得することができる。

【0026】従って、BGA1が実装されたプリント基板2(図12参照)を載置台14に載置し、プリント基板2における実装状態を検査する場合、直線L₁を含み、かつX線入射面12aと平行な関係にある断層画像、いわゆる縦断層画像(図1参照)を取得することができる。これによって、端子部(半田ボール)の浮き上がり不良の検出がし易くなり、パッケージ本体に隠れてしまう接合部における接合状態の良否を明確に判断することができるようになる。

【0027】なお、上記X線検査方法(1)は、X線源11及びX線検出部12の動きから、プリント基板2の縦断層画像を取得することに対して最も有効であるが、例えば、前記接合状態を検査する場合に、プリント基板2の主面に対して垂直方向となる縦断層画像でなく、プリント基板2の主面に対して、斜め方向や水平方向となる断層画像(水平方向の場合には、横断層画像となる)を取得することもできる。

*がX線入射面12aの中心となっているものとする。

【0021】ロ) X線入射面12aと断面13aとの平行関係を維持させたまま、直線L₁を中心軸として、X線検出部12を揺動させる一方、X線源11を直線L₁を回転軸として、X線検出部12に同期させて回転させる。これによって、X線源11はGからgへ移動し、X線検出部12はHからhへ平行移動する。

【0022】ハ) 断面13a上の点A、B、D、E、Fは、hに位置するX線検出部12のX線入射面12aに対し、それぞれ点a、b、d、e、fに入射される。

【0023】図2から明らかなように、X線入射面12aから点a、b、d、e、fまでの距離r₁、r₂、r₃、r₄は、(口)の運動を行っても変化しておらず、また、X線入射面12aに対する断面13a上の各点A、B、D、E、Fの幾何学的拡大率も一定で、次の関係が成立している。

【0024】

※【0028】また、本発明に係るX線検査方法(2)

は、上記X線検査方法(1)において、被検対象となる断面を、前記試料を載置する載置台に対して垂直方向に関する断面とすることを特徴としている。

【0029】上記X線検査方法(2)によれば、被検対象となる断面を、前記載置台に対して垂直方向に関する断面とすることによって、縦断層画像(図1参照)を取得することができる。

【0030】また、本発明に係るX線検査方法(3)は、上記X線検査方法(1)において、被検対象となる断面を、前記試料を載置する載置台に対して垂直方向以外に関する断面とすることを特徴としている。

【0031】上記X線検査方法(3)によれば、被検対象となる断面を、前記載置台に対して垂直方向以外に関する断面とすることによって、前記載置台に対して斜め方向や水平方向となる断層画像を取得することができる。なお、水平方向となる断層画像は横断層画像である。

【0032】また、本発明に係るX線検査方法(4)は、上記X線検査方法(1)又は(2)において、前記中心軸及び前記回転軸となる前記直線を、前記試料を載置する載置台に対して垂直に設定とすることを特徴としている。

【0033】上記X線検査方法(4)によれば、前記直線を前記載置台に対して垂直に設定することによって、縦断層画像を最も効率良く取得することができる。

【0034】また、本発明に係るX線検査装置(1)は、試料を挟んで、X線を照射するX線源とX線を検出するX線検出部とが対向して配置され、前記X線源から照射され、前記試料を透過したX線が前記X線検出部に

て検出されるように構成されたX線検査装置において、前記X線検出部のX線入射面が所定の直線に対し平行となるように配置されると共に、前記X線入射面を常に同方向に向かせたまま、前記X線検出部を、前記直線を中心軸として、揺動させる揺動手段と、前記X線源を、前記直線を回転軸として、前記X線検出部に同期させて回転させる第1の回転手段とを備えていることを特徴としている。

【0035】上記X線検査装置(1)によれば、被検対象となる前記試料を挟んで、前記X線源と前記X線検出部とが対向して配置され、前記X線入射面が前記直線に対して平行となるように配置され、前記X線入射面を常に同方向に向かせたまま、前記X線検出部を前記直線を中心軸として揺動させる一方、前記X線源を前記直線を回転軸として前記X線検出部に同期させて回転させながら、前記X線源からX線が前記試料に照射され、前記試料を透過したX線が前記X線検出部にて検出される。

【0036】すなわち、前記直線を含み、前記X線入射面と平行な関係にある面を基準とし、前記X線源と前記X線検出部とが一定の幾何学的関係を保ったまま互いに運動すると、該運動の基準部分となる面は不動と看做し得る状態となる。

【0037】よって、前記運動の基準部分となる面上にある前記試料の断面が視認の対象となり、それ以外の部分は前記運動の基準部分から遠くなるほど、像の変形が大きくなり、結果的には像がボケてしまっており、視認の対象とならなくなる。

【0038】すなわち、前記直線を含み、前記X線入射面と平行な関係にある前記試料の断面の断層画像を取得することができる。

【0039】従って、BGA1が実装されたプリント基板2(図12参照)における実装状態を検査する場合、前記直線を含み、かつ前記X線入射面と平行な関係にあるプリント基板2の断層画像を取得することができる。

【0040】また、本発明に係るX線検査装置(2)は、上記X線検査装置(1)において、前記直線を含み、かつ前記X線入射面と平行な関係にある面と同一面上にある前記試料の断面を被検対象とし、前記断面が、前記試料を載置する載置台に対して垂直方向にあることを特徴としている。

【0041】上記X線検査装置(2)によれば、被検対象となる断面が、前記載置台に対して垂直方向に関する断面となるので、縦断層画像(図1参照)を取得することができる。これによって、半田ボールの浮き上がり不良の検出がし易くなり、パッケージ内部に隠れてしまう接合状態の良否を明確に判断することができるようになる。

【0042】また、本発明に係るX線検査装置(3)は、上記X線検査装置(1)において、前記直線を含み、かつ前記X線入射面と平行な関係にある面と同一面上

にある前記試料の断面を被検対象とし、前記断面が、前記試料を載置する載置台に対して垂直方向以外にあることを特徴としている。

【0043】上記X線検査装置(3)によれば、被検対象となる断面が、前記載置台に対して垂直方向以外に関する断面となるので、前記載置台に対して斜め方向や水平方向となる断層画像を取得することができる。なお、水平方向となる断層画像は横断層画像である。

【0044】また、本発明に係るX線検査装置(4)は、上記X線検査装置(1)又は(2)において、前記中心軸及び前記回転軸となる前記直線が、前記試料を載置する載置台に対して垂直に設定されていることを特徴としている。

【0045】上記X線検査装置(4)によれば、前記直線が前記載置台に対して垂直方向となるので、縦断層画像を最も効率良く取得することができる。

【0046】また、本発明に係るX線検査装置(5)は、上記X線検査装置(1)～(4)のいずれかにおいて、前記X線検出部を、前記X線入射面に対して垂直方向にスライドさせるスライド機構を備えていることを特徴としている。

【0047】上記X線検査装置(5)によれば、前記X線検出部を、前記X線入射面に対して垂直方向にスライドさせることができるので、前記断層画像の位置の微調整を行うことができる。

【0048】また、本発明に係るX線検査装置(6)は、上記X線検査装置(1)～(5)のいずれかにおいて、前記試料を載置する載置台を2次的に移動させるための載置台移動手段を備えていることを特徴としている。

【0049】上記X線検査装置(6)によれば、前記載置台を2次的に移動させることができるので、所望する前記断層画像を容易に取得することができる。

【0050】また、本発明に係るX線検査装置(7)は、X線を照射するX線源とX線を検出するX線検出部とが配置され、前記X線源から照射され、試料を透過したX線が前記X線検出部にて検出されるように構成されたX線検査装置において、前記X線源を、所定の直線を回転軸として、回転させる第2の回転手段を備えると共に、前記X線検出部が複数配置され、これらX線検出部のX線入射面が、前記直線を含む所定の面を基準とし、回転する前記X線源と一定の幾何学的関係を成立させ得る位置にそれぞれ配設されていることを特徴としている。

【0051】上記X線検査装置(7)によれば、前記直線を含む所定の面を基準とし、回転する前記X線源と一定の幾何学的関係を成立させ得る位置にこれらX線検出部がそれぞれ配置されているので、前記基準部分となる面は不動と看做し得る状態となる。

【0052】よって、前記基準部分となる面上にある前

記試料の断面が視認の対象となり、それ以外の部分は前記基準部分から遠くなるほど、像の変形が大きくなり、結果的には像がボケてしまって、視認の対象とならなくなる。すなわち、前記直線を含む所定の面の断層画像を取得することができる。

【0053】従って、BGA1が実装されたプリント基板2(図12参照)における実装状態を検査する場合、前記直線を含む所定の面のプリント基板2の断層画像を取得することができる。

【0054】

【発明の実施の形態】以下、本発明に係るX線検査装置の実施の形態を図面に基づいて説明する。

【0055】図6は、実施の形態(1)に係るX線検査装置の要部を示した概略図である。図中13は試料を示しており、試料13は載置台14に載置されるようになっている。なお、図6において、載置台14の載置面に垂直な方向をZ方向とし、このZ方向に垂直な2方向をX方向、Y方向とする。また、載置台14は、X線を透過するXYテーブルであり、その下方に設けた載置台移動手段(図示せず)によってX方向、Y方向への移動が可能となっている。このように載置台14の下方に前記載置台移動手段を設けることにより、実装基板のように面積が大きいものであっても、その検査に支障を生じない。

【0056】載置台14を挟んで、X線源11とX線検出部12とが対向して配置され、X線源11からX線が照射され、試料13を透過したX線がX線検出部12にて検出されるようになっている。

【0057】ここではX線源11として、焦点寸法が7μm程度であり、出射角が40度程度である密封管型のマイクロフォーカスX線源を採用し、微小X線焦点を実現することによって、撮像された画像を拡大しても鮮明な画像を得ることができるようにしている。

【0058】X線検出部12は、X線検出部12のX線入射面12aが載置台14に対して垂直方向(Z方向)を向いている軸Sに対し平行となるように配置されている。また、X線検出部12は揺動手段16に連結され、揺動手段16の動きに合わせて、X線入射面12aを常に同方向に向かせたまま、軸Sを中心軸として、矢印Mの方向へ揺動するようになっている。

【0059】X線源11は、回転手段15に連結され、回転手段15の動きに合わせて、軸Sを回転軸として、X線検出部12に同期させて矢印Nの方向へ回転移動するようになっている。なお、回転手段15及び揺動手段17は、移動プログラムを格納した制御手段17からの制御によって、XY方向の動作が制御されるようになっている。

【0060】軸Sを回転軸として回転するX線源11と、軸Sを中心軸として揺動するX線検出部12との運動状態を図7～図9の模式図を使って説明する。図中1

1aはX線源11のX線焦点を示している。図7は運動スタート時の状態であり、図9は運動ストップ時の状態である。

【0061】図7～図9に示したように、X線焦点11a(X線源11)とX線検出部12とを一定の幾何学的関係を維持させたまま互いに運動させると、軸Sを含み、X線入射面12aと平行な関係にある試料13の断面13aは不動と看做し得る状態となる。詳細については、「課題を解決するための手段及びその効果」の項目で説明した通りである。

【0062】また、X線検出部12は、画像処理手段18に接続されており、検出したX線に応じた画像データ(映像信号)が画像処理手段18へ出力されるようになっている。

【0063】画像処理手段18は、運動スタートと同時に画像積分処理を開始し、運動ストップまでに所定回(例えば、256回)、積分処理を行い、画質を改善し、処理画像(静止画像)をモニター19に表示させるようになっている。この処理画像は、上記したように試料13の断面13aにおける断層画像である。

【0064】上記実施の形態(1)に係るX線検査装置によれば、被検対象となる試料13を挟んで、X線源11とX線検出部12とが対向して配置され、X線入射面12aが載置台14に対して垂直方向に向いている軸Sに対して平行となるように配置され、X線入射面12aを常に同方向に向かせたまま、X線検出部12を軸Sを中心軸として揺動させる一方、X線源11を軸Sを回転軸としてX線検出部12に同期させて回転させながら、X線源11からX線が試料13に照射され、試料13を透過したX線がX線検出部14にて検出される。

【0065】すなわち、上記したように、X線源11とX線検出部12とを一定の幾何学的関係を維持させたまま互いに運動させると、該運動の基準部分となる断面13aは不動と看做し得る状態となり、それ以外の部分は前記運動の基準部分から遠くなるほど、像の変形が大きくなり、結果的には像がボケてしまって、視認の対象とならなくなる。

【0066】よって、X線源11の回転軸であり、X線検出部12の中心軸である軸Sを含み、X線入射面12aと平行な関係にある断面13aの断層画像を取得することができる。

【0067】従って、BGA1が実装された状態のプリント基板2(図12参照)を載置台14に載置し、プリント基板2におけるBGA1の実装状態を検査する場合、軸Sを含み、かつX線入射面12aと平行な関係にある縦断層画像(図1参照)を取得することができる。これによって、半田ボールの浮き上がり不良の検出がし易くなり、パッケージ本体により隠れてしまう接合部の接合状態の良否を明確に判断することができるようになる。

11

【0068】また、画像処理手段18にて断層画像を取得するための処理を行わず、単なる画像改善処理だけを行わせるようにすれば、図6に示したX線検査装置を用いて、斜め方向から見た試料13の透視画像(図13参照)を観察することができる。

【0069】従って、プリント基板2における電子部品の実装状態を検査する場合には、まずプリント基板2の主面に対する斜め透視画像を観察することによって、ある程度の当たりを予め付けておくことができるので、縦断層画像による観察は、当たりを付けた箇所だけで良くなり、検査効率を非常に優れたものとすることができる。

【0070】上記実施の形態(1)に係るX線検査装置では、軸Sは載置台14に対して垂直方向に設定されているが、軸Sを載置台14に対して垂直方向以外(斜め方向、水平方向)に設定することもできる。

【0071】例えば、X線入射面12aを、載置台14に対して斜め方向を向いている軸Sに対し、平行となるように配置し、X線検出部12を、X線入射面12aを常に同方向に向かせたまま、軸Sを中心軸として揺動させる一方、X線源11を軸Sを回転軸として回転させながら、X線源11からX線を試料13に照射し、試料13を透過したX線をX線検出部12にて検出すると、垂直方向に対して傾斜した面に関する断層画像を取得することができる。また、軸Sが載置台14面と同一面上にある場合には、試料13を水平方向にスライスした断面の断層画像(横断層画像)を取得することができる。

【0072】また、上記実施の形態(1)に係るX線検査装置では、X線検出部12を、X線入射面12aを常に同方向に向かせたまま、軸Sを中心軸として揺動させる一方(X線検出部12が、図7～図9に示したように揺動する)、X線源11を軸Sを回転軸として回転させながら、X線源11からX線を試料13に照射し、試料13を透過したX線をX線検出部12にて検出するようになっているが、X線検出部12を揺動させるのではなく、例えば、図7～図9に示したような位置にX線検出部12をそれぞれ配置し、固定された複数のX線検出部12から画像データを取得するように構成したとしても、上記と同様に、所望の断層画像を得ることができる。

【0073】

【実施例】図10は、実施例1に係るX線検査装置の要部を模式的に示した側面図である。ここでは、X線源11として、管電圧が100kVであり、焦点寸法が7μmであり、出射角が40度であり、筐体からX線焦点11aまでの距離αが9.5mmである密封管型のマイクロフォーカスを採用している。また、X線検出部12としては、高解像度、高コントラスト、低ノイズであるイメージンテンシファイアを採用している。

【0074】X線源11には、矢印W₁の方向にスライ

12

ドさせるスライド機構(図示せず)が連結され、前記スライド機構を用いることによって、取得画像の大きさを調整することができる。例えば、X線源11を試料13に近づけると、幾何学的拡大率がアップするので、取得画像を大きくすることができる。

【0075】X線検出部12には、矢印W₂の方向にスライドさせるスライド機構(図示せず)が連結され、前記スライド機構を用いることによって、取得画像を微量調整することができる。例えば、X線検出部12を軸Sに近づけると、試料13の断面13aの上部がカットされた断層画像を取得することができる。

【0076】載置台14に試料13として、BGA1が実装されたプリント基板(図12参照)を載置することによって、縦断層画像(図1参照)を取得することができる。これによって、半田ボールの浮き上がり不良の検出がし易くなり、パッケージ本体により隠れてしまう接合部の接合状態の良否を明確に判断することができるようになる。

【0077】前記密封管型のマイクロフォーカスは、出射角が40度であるため、X線源11から照射されたX線がX線検出部12のX線入射面12aに入射されるように、X線源11が傾けられている。X線源11が傾けられると、X線焦点11aと試料13との距離が離れるので、幾何学的拡大率は低下してしまうが、通常の産業用としては特に問題はない。

【0078】また、密封管型ではなく開放管型であれば、焦点寸法が2μmであり、出射角が120度であり、筐体からX線焦点までの距離が1mmのマイクロフォーカスを実現することができるので、それをX線源11に採用すれば、X線源11を傾けなくとも良く、また筐体からX線焦点までの距離も密封管型に比べて、10倍近く短くなっているため、拡大率を大幅に向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】BGAとプリント基板との接合箇所の縦断層画像を示した模式図である。

【図2】本発明のX線検査方法を説明するために示した模式的平面図である。

【図3】本発明のX線検査方法を説明するために示した模式的正面図である。

【図4】本発明のX線検査方法を説明するために示した模式的側面図である。

【図5】試料を模式的に示した斜視図である。

【図6】本発明における実施の形態(1)に係るX線検査装置の要部を示した概略図である。

【図7】X線源とX線検出部との運動状態を示した模式図である。

【図8】X線源とX線検出部との運動状態を示した模式図である。

【図9】X線源とX線検出部との運動状態を示した模式

図である。

【図10】実施例1に係るX線検査装置の要部を模式的に示した側面図である。

【図11】BGAの一例を模式的に示した斜視図である。

【図12】BGAが実装された状態のプリント基板を模式的に示した斜視図である。

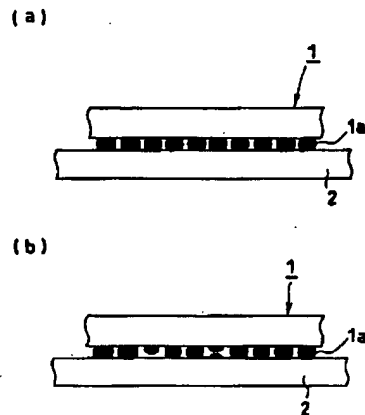
【図13】BGAとプリント基板との接合箇所を撮影したX線写真である。

【図14】半田ボールの浮き上がり不良の状態を示した模式図である。

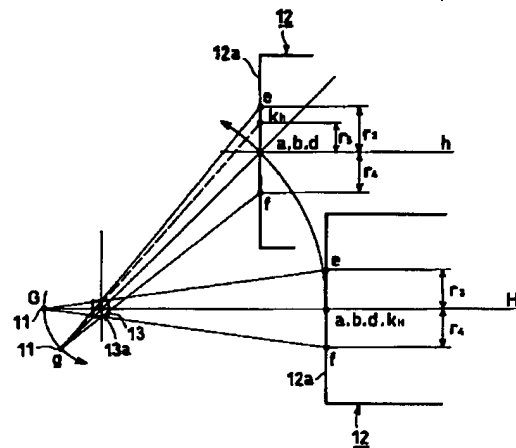
【符号の説明】

- 11 X線源
- 11a X線焦点
- 12 X線検出部
- 12a X線入射面
- 13 試料
- 14 載置台
- 15 回転手段
- 16 揺動手段
- 18 画像処理手段

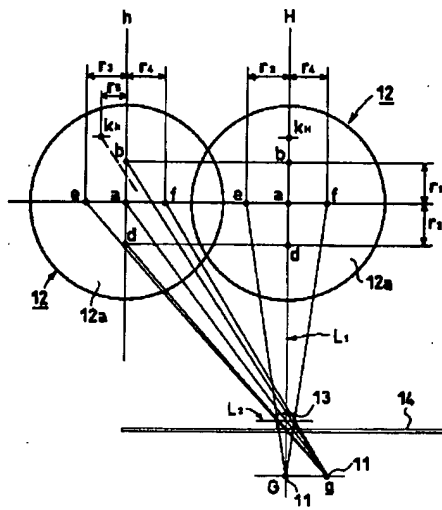
【図01】



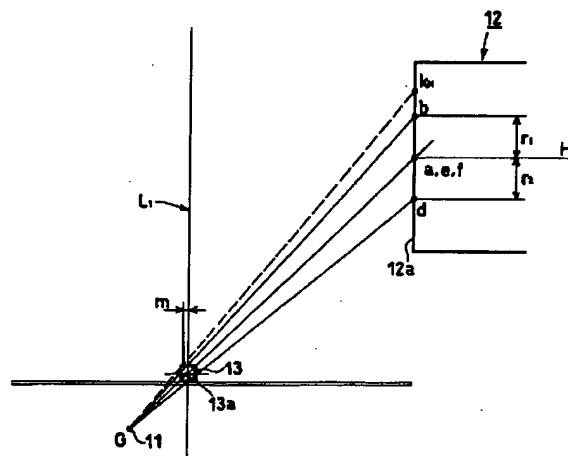
【図02】



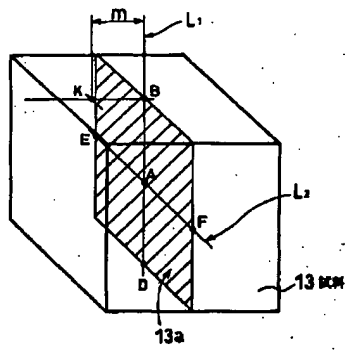
【図03】



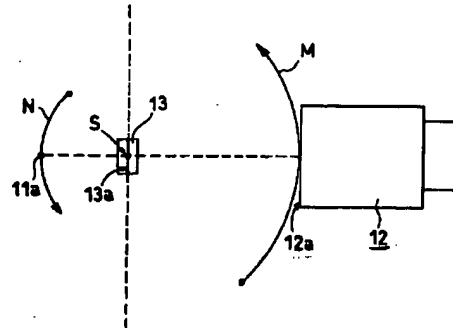
【図04】



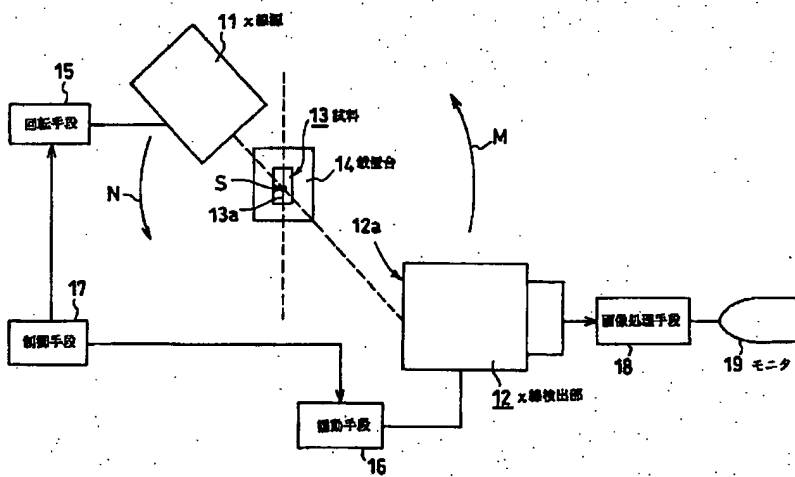
【図05】



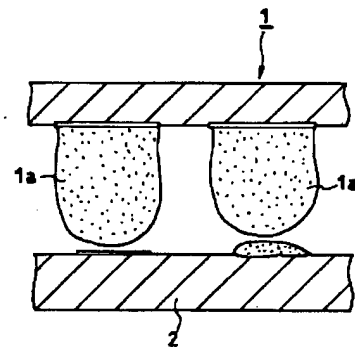
【図08】



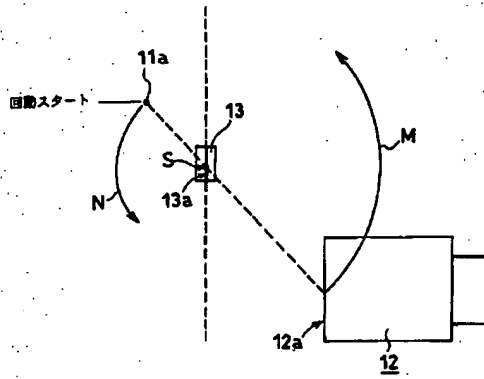
【図06】



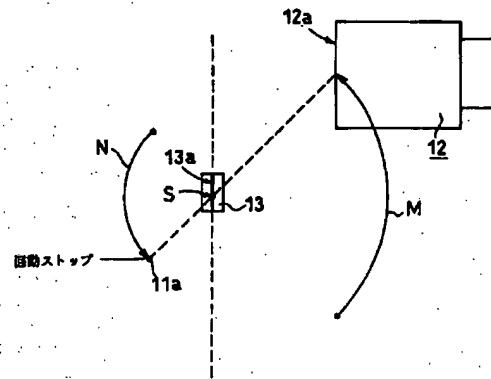
【図14】



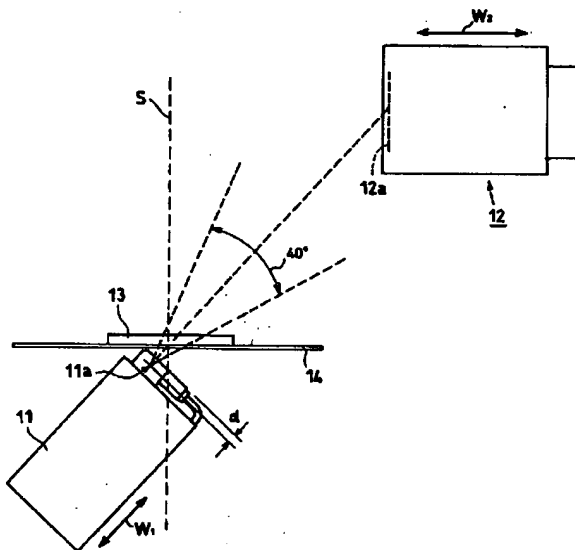
【図07】



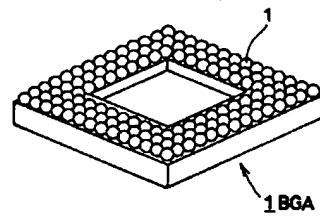
【図09】



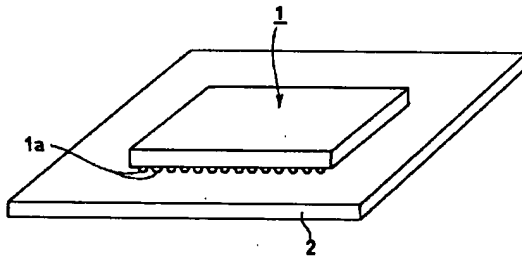
【図10】



【図11】



【図12】



【図13】

